

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-016

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	民生证券、信达澳亚基金
时间	2024年5月17日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司 AMOLED 的营收占比及主要客户？</p> <p>答：受惠于 AMOLED 在手机及平板应用的渗透率持续增加、显示面板产业向中国大陆转移以及国内显示芯片供应链已趋于完善等因素，AMOLED 营收占比逐步增加，2024 年第一季度 AMOLED 营收占比接近 25%。目前 AMOLED 主要客户有联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显微、OmniVision Touch and Display、集创北方等。</p> <p>2. 问：公司非显示业务的营收占比如何，未来展望是什么？</p> <p>答：2024 年第一季度公司非显示业务的营收占比约 10%，非显示类芯片的封测业务是未来公司优化产品结构、利润增长和战略发展的重点，公司高度重视非显示类业务的发展。在封测产品方面，公司将把握中国大陆 IC 设计企业在相关领域快速发展的良好契机，继续巩固和加强在电源管理、射频前端等芯片先进封测业务的量产。在已有技术的基础上，公司着力于 12 吋晶圆各类金属凸块技术的深度研发，同时大力发展基于砷化镓、氮化镓、钽酸锂等第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测业务，不断增强相关产品的生产能力和规模效应，进一步降低生产成本，从而提升公司的盈利能力。</p> <p>3. 问：公司产品的终端应用的营收占比如何？</p> <p>答：由于公司仅为客户提供封装测试服务，客户不会明确告知所封测芯片的终端应用情况，因此公司结合产品指标、下游客</p>

	户收入结构等特性，分析所封测芯片的主要终端应用领域情况。分析结论为：2023年度，显示业务方面，高清电视与智能手机各自占比约40%以上，笔记本电脑约为8%；非显示业务方面，电源管理占比超50%，射频前端占比接近45%。2024年第一季度，显示业务方面，高清电视占比超30%，智能手机占比超50%，笔记本电脑约为8%；非显示业务方面，电源管理占比超50%，射频前端占比接近45%。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月20日